

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	
参与单位及人员	中邮证券-吴文吉 欣荣拓展-沈喆强 中泰证券-王九鸿 中信资管-曹苍剑 第五公理-郭雷雨 兴亿投资-梁悦芹 中泰证券-李雪峰 华安基金-陈淳 招商基金-袁哲航 交银施罗德-于畅 中信证券-晏磊 国融基金-陈晓晨 中金资本-邹臣 兴业基金-肖斌 兴银基金-王卫 泰康资产-李萌 东方基金-梁忻 光大保德信-魏晓雪 兴证全球-章书崑 长城财富保险-杨海达 申万宏源-杨海晏	银华基金-郭磊 中邮人寿保险-陈昭旭 摩根士丹利-李子扬 光大证券-尚青 招商信诺-刘泽宇 兴证全球基金-沈度 国信证券-胡慧 申银万国-袁航 国泰君安-巫凯洋 东北证券-武芃睿 银华基金-郭磊 华鑫电子-张璐 长城证券-邹兰兰 中信证券-何鑫圣 国信证券-张大为 投中资本-张盟 开源证券-刘天文 西部利得-侯文佳 中信证券-陈旺 山西证券-高宇洋 国投证券-郭旺

时间	2024年10月28日
地点	电话会议
接待人员	董事会秘书常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司本季度经营情况</p> <p>公司2024年第三季度营业收入为8888.96万元，同比增加约120.32%，环比增加约32.87%；今年前三季度已实现营业收入累计约2.14亿元，同比增加约79.65%；第三季度单季度实现归属于上市公司股东的净利润2272.39万元，连续第三个季度实现盈利，今年前三季度已实现净利润总额约2748.60万元。</p> <p>经过2023年行业低谷后，半导体行业整体逐渐走入回升期：终端市场回暖，客户需求逐渐增加，国内半导体产业链持续壮大。2024年年初以来，公司销售订单和出货持续增加。</p> <p>本报告期内，国内市场需求持续提升，但大直径硅材料产品海外市场尚未完全恢复。公司积极获取和扩大客户订单，取得了一定成效。公司的硅零部件产品销售规模持续提升，重点客户出货数量持续增加，正在为半导体设备国产自主做出独特贡献。</p> <p>二、 公司第三季度毛利率环比改善的原因</p> <p>公司第三季度毛利率的改善，主要体现在大直径硅材料和硅零部件两大业务上：大直径硅材料业务的毛利率提升主要来自成本端优化，硅零部件业务则在产品品类结构上有所改善。此外，硅片业务的排产计划优化，也有所贡献。综上因素，促成了公司第三季度毛利率的整体环比提升。</p> <p>三、 硅零部件业务的增长情况</p> <p>公司硅零部件产品面向中国大陆市场销售，主要供给两大领域的客户：国产等离子刻蚀机原厂，例如北方华创等公司；国内集成电路制造企业，例如长江存储等公司。本报告期内，公司向前一领域的出货相对较多。随着国产半导体设备厂商追赶乃至超越国际先进水平，相应的研发机台转换为量产机台，为包括公司在内的众多国产供应链配套企业带来了新的发展机遇。</p> <p>四、 目前国内市场竞争情况</p> <p>公司所处行业具有“资金壁垒高、技术壁垒高、市场壁垒高”的特征。仅就</p>

	<p>公司目前掌握的信息，国内半导体级大直径硅材料及硅零部件生产厂商数量没有变化。公司是全球范围内少数具备“材料+加工”一体化能力的厂商，在质量、成本、研发等方面都具备很强的自主控制力，拥有长期竞争优势。</p> <p>五、 近阶段半导体行业趋势及其对公司的影响</p> <p>公司观察到，当前半导体景气度上行的动力，与以往历次周期都完全不同：本次上行的主要推动力是下游企业的巨额投资，而非以往的大众消费电子产品。根据权威市场机构的数据，2024年个人电脑和智能手机出货量增长只有2%-3%。</p> <p>因此，本次半导体景气度上行体现出极为强烈的“结构性”和“阶段性”特征，这体现在SEMI的一系列预测数据中：2024年全球半导体销售额同比增长预计为20%，除去大宗存储芯片后为10%，再除去人工智能相关的HBM和企业级SSD后，增长只有3%。这一数字与前述个人电脑和智能手机的增长数据是匹配的，显示大众消费电子产品增长乏力，并非半导体景气度上行的主要动力。</p> <p>公司研判认为：美国六大科技巨头——Amazon、Apple、Alphabet、Microsoft、Meta、Tesla——对人工智能数据中心的资本开支，带动了先进制程高端芯片的需求增加，是本轮半导体景气度上行最重要的动力源；除了美国科技巨头的资本开支，中国芯片制造产能的国产化浪潮是第二大动力源，SEMI数据显示2024年全球芯片制造产能的增长预计只有3%，而中国为15%。</p> <p>神工股份的大直径硅材料业务和硅零部件业务，分别受益于国内国外这两大投资动力源：大直径硅材料业务，通过海外硅零部件制造厂客户，切入了海外市场先进制程的产能扩张；硅零部件业务，通过中国本土等离子刻蚀机原厂及集成电路制造厂客户，切入了中国本土市场成熟制程的国产化产能扩张。</p> <p>未来，公司管理层将密切关注下游需求变化，争取在当前的结构性行情中巩固已有的优势生态位，取得更好的业绩。</p>
附件清单	无
日期	2024年10月30日